



郵便はがき



料金後納
郵便

株主通信

第23期上半期

自2024年4月1日 至2024年9月30日



株式会社ジエダット <証券コード：3841>

当冊子に関するお問合せ先

株式会社ジエダット 経営管理本部
東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲 Tel：03-6262-8400 (代)
E-mail：corporate.planning1@jedat.co.jp

中面にお知らせがあります。万一ぬれている場合はよく乾かしてからご覧ください。

SMCのOIP EDA Allianceに加入

2024年7月、ジエダットはTSMCのOpen Innovation Platform®でのEDA Allianceに加入しました。TSMC OIP EDA Allianceのメンバーは、TSMCの業界をリードするプロセス技術と3DFabric技術を用い、高品質かつ実績のある電子設計自動化(EDA*) ツールとサービスを顧客に提供し、次世代の半導体設計を可能にしています。ジエダットは、同アライアンスに加わることで、主力製品であるSX-Meisterを通じてTSMCの顧客へのサポートをさらに強化します。

*EDA(Electronic Design Automation)：半導体やプリント基板等の電子設計用CADシステム

株式数及び株主数 (2024年9月30日現在)

発行可能株式総数	7,800,000 株
発行済株式総数	3,909,800 株
株主数	1,935 名

株主メモ

上場市場	東京証券取引所 スタンダード市場
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当基準日	3月31日
株式の売買単位	100株
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
事務取扱場所	みずほ信託銀行株式会社
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 https://www.jedat.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載します。

会社概要 (2024年9月30日現在)

商号	株式会社ジエダット (Jedat Inc.)
所在地	〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲
代表者	代表取締役社長 松尾 和利
営業開始	2004年2月2日
資本金	762,524,260 円
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。2025年3月期上半期の業績をご送付申し上げます。

当中間会計期間における売上高は9億68百万円（前年同期比9.4%増）となり増収となりました。営業利益は固定費が増加したこともあり87百万円（前年同期比1.8%増）となりました。経常利益は、円高による為替差損等の影響により、94百万円（前年同期比30.2%減）となり、中間純利益は、繰延税金資産の取崩し等の影響により65百万円（前年同期比51.2%減）となりました。

当中間会計期間における、当社の主要顧客である半導体等をはじめとした電子部品業界は、スマートフォンやパソコン向けのオンデバイスAI期待はまだ道半ばですが、前年度に底打ちした状況からは各社の在庫調整も進み、緩やかに回復の兆しが見えてきております。また、EV化の減速感是否めないもののパワー半導体の需要は底堅く、各社の設計設備、生産設備への投資は盛んであります。

このような状況の中、当社は産官学との協力関係を深めアナログ半導体向け設計環境の効率化を追求し続けており、主力製品であるSX-MeisterのアナログLSIの設計自動化に向けたACC (Analog Chip Complier) の機能拡張版およびパワー半導体の設計分野に向けたツールの機能拡張版をリリースするなど製品の競争力を強化するとともに、開発部門の人員増強や最先端プロセス対応に向けた開発組織に変更するなど開発力の強化に努めております。さらにはプライベートセミナーを開催し、AI活用による新たなソリューションを紹介するなどの活動も行っております。また、2024年7月にはTSMCのOIP (Open Innovation Platform) EDA Allianceに加入しました。この加入により、当社の主力製品であるSX-Meisterを使用してアナログやイメージセンサー、メモリ等の設計効率をさらに向上させ、TSMCの最先端プロセス技術でお客様のイノベーションを加速していくこととなります。国内の販売促進活動においては、仏XYALIS社、同じく仏POLLEN社と国内販売代理店契約を締結、競争力のある代理店製品を拡充し、それらを活用した営業活動を積極的に展開しております。デバイス設計受託サービスにおいては、顧客開拓活動を積極的に実施した結果、売上は順調に推移しました。

下半期におきましても、主力製品の更なる機能強化と販売促進の強化に努め、また、上半期に新規で契約した販売代理店の製品販売を加速するなどして更なる拡販を目指し、年間計画達成を目標に活動してまいります。

株主の皆様におかれましては引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長

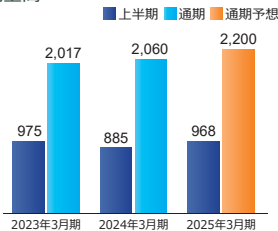
松尾和利

中間会計期間 売上高 (単位:百万円)

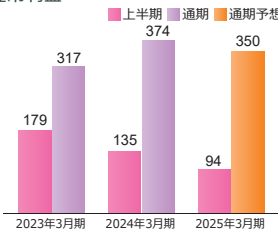
		2024年3月期	2025年3月期		
		実績	期初計画	実績	前年同期比
事業別売上高	製品	486	607	517	+ 6.4%
	サービス	208	217	205	△ 1.0%
	ソリューション	191	202	245	+ 28.0%
市場別売上高	半導体市場	663	775	747	+ 12.7%
	FPD市場	222	252	221	△ 0.5%
製品区分別売上高	自社開発製品	723	796	771	+ 6.6%
	代理販売製品	162	230	197	+ 21.6%
売上高合計		885	1,027	968	+ 9.4%

財務ハイライト (単位:百万円)

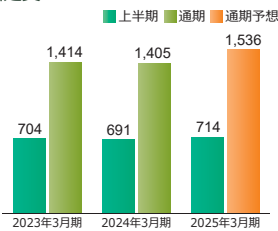
売上高



経常利益



固定費



総資産・自己資本

